

第10回 NanoHubワークショップ

半導体デバイスの熱マネージメントの現状整理と新展開
～産学連携のランドスケープを共有する～

2025年5月12日 14:00-18:00（意見交換会：18:00-20:00）

東京大学本郷キャンパス 山上会館・大会議室
参加費・意見交換会 無料 要事前登録（定員有100名）

プログラム
座長 許斌 東京大学大学院工学研究科・特任講師

【開会の挨拶】
・ 14:00～14:05 加藤泰浩 東京大学大学院工学系研究科 研究科長

【二エズ講演】
・ 14:05～14:20 松本 圭司 IBM Research-Tokyo
「フリップチップパッケージの放熱における取り組み」
・ 14:20～14:35 加藤 良隆 株式会社ミライズテクノロジー
「次世代モビリティ向けパワーモジュールにおける熱課題と期待される放熱技術」
・ 14:35～14:50 山縣 利貴 デンカ株式会社
「放熱材料開発の現状と課題」
・ 14:50～15:05 西川 泰司 株式会社カネカ
「黒鉛系のサーマルインターフェイスマテリアルとヒートスプレッダー」
(休憩 15:05-15:20)

【シエズ講演】
・ 15:20～15:35 長野 方星 名古屋大学工学研究科・教授
「μループヒートパイプによる3DIC冷却ソリューションの創出」
・ 15:35～15:50 野村 政宏 東京大学生産技術研究所・教授
「AIN絶縁層導入による3DICの放熱促進」
・ 15:50～16:05 田嶋 一樹 産業技術総合研究所ナノ材料研究部門・主任研究員
「接着接合技術を用いた電子デバイスの熱マネジメント」
・ 16:05～16:20 内田 建 東京大学大学院工学研究科・教授
「フォノンエンジニアリングによる低温CMOSの高性能化指針」
・ 16:20～16:35 塩見 淳一郎 東京大学大学院工学研究科・教授
「界面フォノンエンジニアリングによる半導体デバイスの放熱促進」
(休憩 16:35-16:50)

・ 【パネルディスカッション】 16:50～17:40
・ パネリスト：花村 克悟 JST研究開発戦略センター・上席フェロー
野村 政宏 東京大学生産技術研究所・教授
長野 方星 名古屋大学工学研究科・教授
松本 圭司 IBM Research-Tokyo・リサーチサイエンティスト
太田 アウン 株式会社デンソー研究開発センター 研究開発部 担当課長
・ モデレータ：塩見 淳一郎 東京大学大学院工学研究科・教授

【閉会の挨拶】 17:40～17:45 竹中充 東京大学大学院工学研究科・教授

参加申込



主催：東京大学 大学院工学系研究科 附属ナノシステム集積センター
共催：量子科学技術国際卓越大学院プログラムQSTEP
東京大学 国際オープンイノベーション機構
協賛：連携研究機構マテリアルイノベーション研究センター（MIRC）
システムデザイン研究センター（d.lab） 基盤デバイス研究部門
申込：https://forms.gle/Zb7yWTm9e8Azzjeu9
最新版情報：https://www.if.t.u-tokyo.ac.jp/~mita/NanoHubWS10_12May25.pdf
連絡先：ナノシステム集積センター(NanoHub)事務局 <today-nanohub@kumamoto-u.ac.jp>

フライヤー

